【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公開番号】特開2007-63621(P2007-63621A)
【公開日】平成19年3月15日(2007.3.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-010
【出願番号】特願2005-251017(P2005-251017)
【国際特許分類】
Ｃ２２Ｃ　21/00　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　14/34　(2006.01)
Ｃ２２Ｆ　1/04　(2006.01)
Ｃ２２Ｆ　1/02　(2006.01)
Ｃ２２Ｆ　1/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２２Ｃ　21/00　Ａ
Ｃ２３Ｃ　14/34　Ａ
Ｃ２２Ｆ　1/04　Ｄ
Ｃ２２Ｆ　1/02
Ｃ２２Ｆ　1/00　６０４
Ｃ２２Ｆ　1/00　６１２
Ｃ２２Ｆ　1/00　６１３
Ｃ２２Ｆ　1/00　６２３
Ｃ２２Ｆ　1/00　６４０Ｂ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６４０Ｚ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６６１Ａ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６６１Ｚ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６８１
Ｃ２２Ｆ　1/00　６８２
Ｃ２２Ｆ　1/00　６８３
Ｃ２２Ｆ　1/00　６８５
Ｃ２２Ｆ　1/00　６９１Ｂ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６９１Ｃ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６９４Ａ
Ｃ２２Ｆ　1/00　６９４Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月20日(2008.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
ここで、加工率（％）とは、圧延の場合は加工前後の厚さ減少率で、押出の場合は〔1-（加工後の断面積／加工前の断面積）〕×100で表す。
２）熱間圧延の上がり板厚の段階で結晶粒を小さくする方法である。この方法では熱間圧延中に再結晶を起こさせることが必要であり、圧延温度と加工率が重要になってくる。すなわち温度が300～500℃の範囲での１パスでの加工率がR（％）≧－0.1T＋80（T：温度（℃））で表される条件で行うと、そこで再結晶が起こりやすくなる。